西村証券 企業調査速報

2025/02/25

［金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第26号：加入協会‥日本証券業協会］

ＴＯＷＡ（コード 6315）

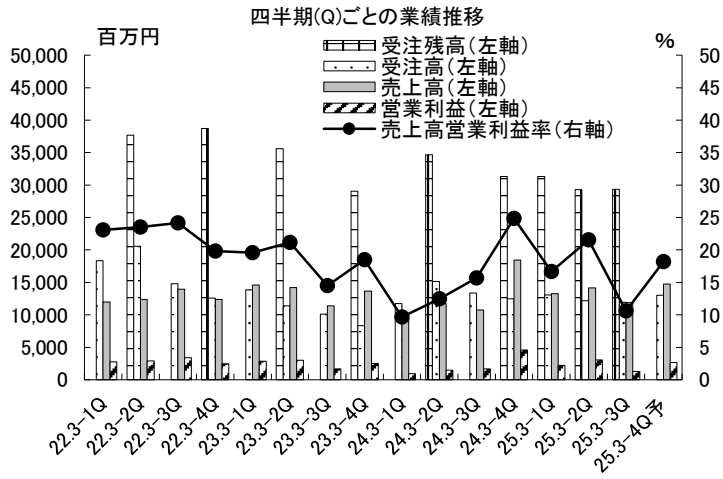
◆各決算期の第３四半期業績推移(連結)（株式分割を考慮。第３四半期の CF は非開示）

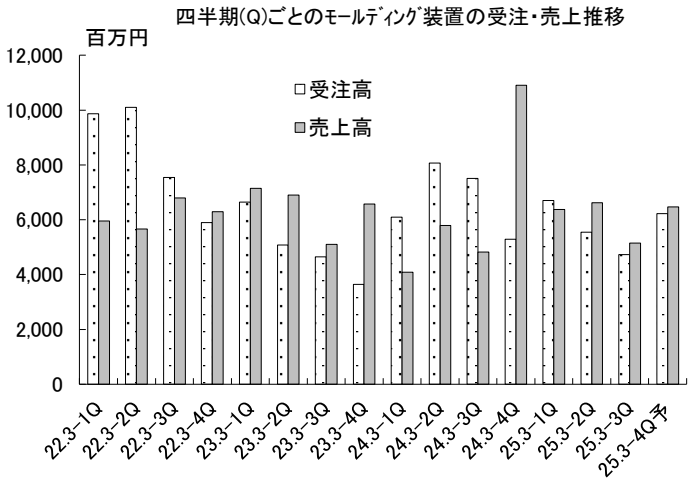
決算期	売上高	営業利益	1株純利益	1株配	営業CF	投資CF	財務CF	現金及び現金同等物
22.3	38,291	9,051	88.2	－	－	－	－	－
23.3	40,171	7,513	75.1	－	－	－	－	－
24.3	32,032	4,075	41.5	－	－	－	－	－
25.3	39,259	6,521	68.7	－	－	－	－	－

◆通期業績推移(連結)（25.3 予は会社側発表値。株式分割を考慮）

決算期	売上高	営業利益	1株純利益	1株配	営業CF	投資CF	財務CF	現金及び現金同等物
22.3	50,666	11,505	108.4	16.7	6,403	▲6,600	1,925	12,250
23.3	53,822	10,037	97.9	13.3	2,831	▲2,746	3,962	16,430
24.3	50,471	8,661	85.9	13.3	9,665	▲2,773	▲3,524	20,517
25.3予	54,000	9,200	104.9	20.0	－	－	－	－

（CF＝ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ。現金及び現金同等物は各期末値。▲はマイナス。単位は百万円、円）



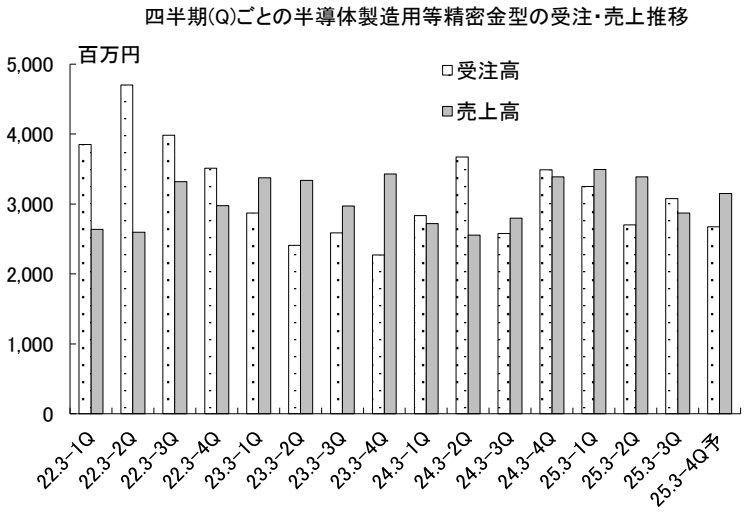


25 年 3 月期第 3 四半期の業績概況…25 年 3 月期第 3 四半期累計期間（24 年 4～12 月）は、中国での半導体内製化に向けた装置・金型の納入が継続していることに加え、同社独自のコンプレッション装置・金型が好調に推移していることからモールディング装置・金型の売上が増加。顧客の稼働率改善や納入台数の伸びに伴って TSS（トータル・ソリューション・サービス）など新事業も好調に推移。売上高は前年同期比で約 23%、営業利益は 60%それぞれ増加した。

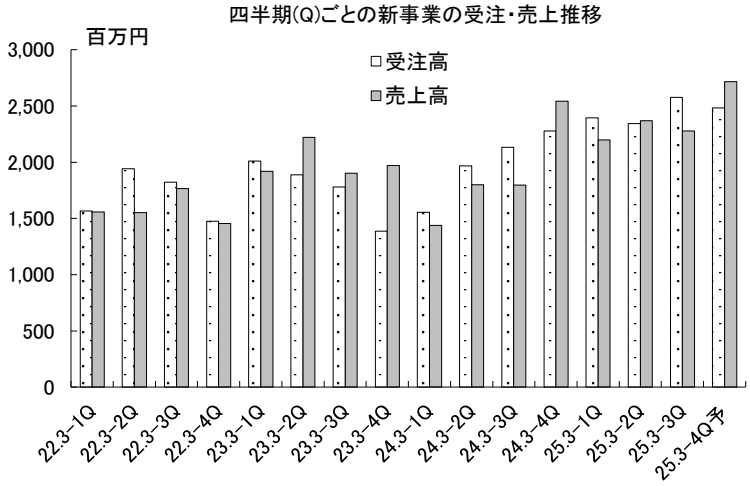
当期の業績は、売上高 392 億 5,900 万円（前年同期比 22.6%増）、営業利益 65 億 2,100 万円（同 60.0%増）、経常利益 70 億 8,200 万円（同 64.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益 51 億 5,200 万円（同 65.5%増）となった。

セグメント別の売上高は、半導体製造装置事業 361 億 2,200 万円（同 26.1%増）、化成品（ファインプラスチック成形品）事業 17 億 3,000 万円（同 6.5%増）、レーザ加工装置事業 14 億 600 万円（同 19.9%減）で、半導体製造装置事業のうち、半導体製造用等精密金型 97 億 5,000 万円（同 20.8%増）、モールディング装置 181 億 3,500 万円（同 23.3%増）、新事業 68 億 4,500 万円（同 35.9%増）など。また、セグメント別の営業利益では、半導体製造装置事業 62 億 200 万円（同 70.9%増）、化成品事業 3 億 6,900 万円（同 4.4%増）、レーザ加工装置事業 5,000 万円の損失（前年同期は 9,100 万円の黒字）となった。

当期の受注高は 371 億 8,500 万円（同 7.6%減）に減少したものの、当期末の受注残高は 293 億 7,000 万円（24 年 9 月末 292 億 8,000 万円）と高水準を維持。セグメント別の受注高については、半導体製造装置事業 342 億 3,700 万円（同 7.0%減）、化成品事業 17 億 200 万円（同 5.8%増）、レーザ加工装置事業 12 億 4,300 万円（同 32.2%減）で、半導体製造装置事業のうち、半導体製造用等精密金型 90 億 2,700 万円（同 0.6%減）、モールディング装置 169 億 7,300 万円（同 21.7%減）、新事業 73 億 1,800 万円（同 29.4%増）などとなっている。



一方、第 3 四半期（同年 10～12 月）に限ると、売上高は前年同期比で約 10%伸びたものの、モールディング装置において相対的に利益率の高いコンプレッション装置の売上が少なかったこと（商品構成の変化）などにより、営業利益は約 25%減少。売上高営業利益率（10.6%）は 24 年 3 月期第 1 四半期（23 年 4～6 月。9.7%）以来の低水準となった。



25 年 3 月期の通期業績見通し…25 年 3 月期の通期業績は、受注高 502 億円（前期比 4.8%減。今期中間期決算時点での計画値 512 億円）、売上高 540 億円（同 7.0%増。修正前 600 億円）、営業利益 92 億円（同 6.2%増。修正前 126 億円）、経常利益 97 億 6,000 万円（同 7.5%増。修正前 126 億円）、親会社株主に帰属する当期純利益 78 億 7,000 万円（同 22.1%増。修正前 88 億 3,000 万円）の見通しで、受注高以外（期初計画 600 億円）は期初時点での会社側発表値から下方修正されている。

主力の半導体製造装置事業について、セグメント別売上高予想は 494 億 6,000 万円（同 7.8%増。修正前 550 億円）で、このうち、半導体製造用等精密金型が 129 億円（同 12.6%増。修正前 134 億円）、モールディング装置が 246 億円（同 3.9%減。修正前 295 億円）、新事業が 95 億 6,000 万円（同 26.2%増。修正前 96 億円）など。また、セグメント別受注高予想は 463 億円（同 4.1%減。修正前 476 億円）で、このうち、半導体製造用等精密金型が 117 億円（同 7.0%減。修正前 114 億円）、モールディング装置が 232 億円（同 14.0%減。修正前 248 億円）、新事業が 98 億円（同 23.5%増。修正前 96 億円）などとなっている。

本レポートは、会社側が発表した決算短信や決算説明資料などに基づき作成しており、証券投資の参考となる情報の提供を目的としたもので、証券の売買を勧誘する目的で作成したものではありません。株式の売買取引には、約定代金に対して手数料が必要となります。また、株式は、株価の変動により損失が生じる恐れがあります。投資に関する最終決定は、投資家ご自身の判断でなさいますようお願い致します。本レポートは各種データに基づいて作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありませんので、予めご了承下さい。なお、本レポートの著作権は西村証券に帰属しており、電子的・機械的などの方法を問わず、無断で本レポートを引用または複製、転送することを禁じます。